**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

k výběrovém řízení s názvem:

***„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – část 2 – Simulační software pro PCB“***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Simulační software pro pcb** | | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | ……………. (*doplní účastník*) | | |
| **Požadovaný parametr** | | | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| **Základní prostředí pro simulace mikrovlnných obvodů** | | | | |
| Import a správa dat z CAD systému Solid Edge, SolidWorks a AutoCAD. | | | Ano |  |
| Možnost importu ECAD dat z Cadence, Mentor, Zuken, Eagle, Altium. | | | Ano |  |
| Otevírání datových formátů: Parasolid, STEP, STL a DXF. | | | Ano |  |
| Možnost instalace pod 64-bit op. systémem Windows a Linux. (*nebo jiné adekvátní řešení*)\* | | | ANO |  |
| Preprocesor pro přípravu prostorových geometrických modelů plně integrovaného do jednotného uživatelského prostředí umožňující parametrizaci modelu pro spouštění variantních úloh. | | | ANO |  |
| Schopnost automatizace časově náročných úloh. | | | Ano |  |
| Možnost rozšíření o řešení výpočtů na připraveném cloudu s odesláním úlohy přímo z programu. | | | ANO |  |
| Možnost dočasně rozšířit licence o licenční kredity. | | | ANO |  |
| Paralelizace výpočetních úloh na 4 procesorová jádra v základu s možností budoucího rozšíření. | | | ANO |  |
| Plná kompatibilita preprocesoru a postprocesoru se zvoleným řešičem. | | | Ano |  |
| **Požadované typy  analýz:** | simulace vysokofrekvenčního elmag. pole na úrovni 3D a PCB | | Ano |  |
| frekvenční a časový FEM řešič, MoM řešič | | ANO |  |
| modul pro automatický návrh 3D i planárních anténních struktur | | ANO |  |
| automatický návrh planárních filtrů na základě topologie a výsledných parametrů | | ANO |  |
| možnost rozdělení komplexního modelu na jednodušší submodely | | ANO |  |
| práce s předdefinovanými komponenty s možností vytvoření vlastních | | ANO |  |
| možnost definice nezávislých regionů pro akceleraci síťovacího a výpočetního procesu | | ANO |  |
| simulace RF a mikrovlnných prvků | | Ano |  |
| vysoko a nízkofrekvenční obvodové (systémové) simulace | | Ano |  |
| základní analýzy napájecí a signálové integrity PCB | | Ano |  |
| technologie planárních mikroelektrických struktur | | Ano |  |
| elektromagnetická kompatibilita a interference | | Ano |  |
| návrh mikropáskových obvodů | | Ano |  |
| návrh oscilátorů, filtrů, směšovačů, antén, radarů | | ANO |  |
| možnost automatické adaptivní tvorby sítě | | Ano |  |
| parametrické, optimalizační a statické výpočty | | Ano |  |
| tvorba SPICE, Touchstone modelů | | Ano |  |
| možnosti skriptování a programování | | Ano |  |
| Knihovna materiálů a součástek výrobců tranzistorů, diod, integrovaných obvodů. | | | Ano |  |
| Trvalá licence bez nutnosti dokupovat další časově omezenou podporu. | | | Ano |  |

*\*z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se současným provozem*